



## 平成23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成22年11月10日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社 東京精密

コード番号 7729 URL <http://www.accrettech.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 藤森 一雄

問合せ先責任者 (役職名) 代表取締役業務会社執行役員社長 (氏名) 太田 邦正

四半期報告書提出予定日 平成22年11月12日

配当支払開始予定日

TEL 042-642-1701

平成22年12月1日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (アナリスト・機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成23年3月期第2四半期の連結業績(平成22年4月1日～平成22年9月30日)

#### (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23年3月期第2四半期	23,562	105.3	2,971	—	2,253	—	2,388	—
22年3月期第2四半期	11,476	△63.9	△1,988	—	△2,384	—	△3,815	—

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円銭	円銭
23年3月期第2四半期	57.94	57.89
22年3月期第2四半期	△94.81	—

#### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円銭
23年3月期第2四半期	73,542	41,527	56.3	1,004.28
22年3月期	69,485	39,050	56.0	944.06

(参考) 自己資本 23年3月期第2四半期 41,390百万円 22年3月期 38,904百万円

### 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円銭	円銭	円銭	円銭	円銭
22年3月期	—	0.00	—	0.00	0.00
23年3月期	—	5.00	—	—	—
23年3月期(予想)	—	—	—	5.00	10.00

(注) 当四半期における配当予想の修正有無 有

### 3. 平成23年3月期の連結業績予想(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円銭
通期	47,000	52.9	5,000	—	4,000	—	3,800	—	92.20

(注) 当四半期における業績予想の修正有無 有

4. その他（詳細は、【添付資料】P.4「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 無

新規 一社（社名 ）、除外 一社（社名 ）

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 有

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年3月期2Q 41,245,581株 22年3月期 41,241,081株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q 31,693株 22年3月期 31,599株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年3月期2Q 41,212,216株 22年3月期2Q 40,241,648株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続を継続しております。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信(添付資料)3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 .....	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報 .....	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報 .....	3
(3) 連結業績予想に関する定性的情報 .....	3
2. その他の情報 .....	4
(1) 重要な子会社の異動の概要 .....	4
(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 .....	4
(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 .....	4
3. 四半期連結財務諸表 .....	5
(1) 四半期連結貸借対照表 .....	5
(2) 四半期連結損益計算書 .....	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 .....	8
(4) 継続企業の前提に関する注記 .....	9
(5) セグメント情報 .....	9
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 .....	10
4. 補足情報 .....	11
(1) 生産、受注及び販売の状況 .....	11

## 1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

### (1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第 2 四半期連結累計期間の内外経済情勢は、米国における雇用や不動産市場などの回復の遅れ、日本における円高影響による輸出伸び悩みなど、先進国においては不透明な景況が続きましたが、中国・インドなど新興国の内需拡大による高い経済成長に牽引され、総じて回復基調を辿りました。

半導体関連市場においては、スマートフォン（高性能携帯電話）やタブレット P C の急拡大、産業機器や自動車関連半導体デバイスの堅調な需要などにより、半導体メーカーの設備投資も活発に推移しました。しかし後半には P C やデジタル家電の不透明感から、一部半導体メーカーは投資に慎重になっています。

計測機器事業の主要ユーザーである自動車関連業界や工作機械業界においては、中国等アジア新興国主体に市況が堅調に推移し、設備投資も回復を続けております。

このような状況の中で当第 2 四半期連結累計期間の連結業績は、売上高 235 億 62 百万円（前年同期比 105.3%増）、営業利益 29 億 71 百万円（前年同期は△19 億 88 百万円）、経常利益 22 億 53 百万円（前年同期は△23 億 84 百万円）となりました。

三鷹日本社売却に伴う特別利益 8 億 72 百万円、投資有価証券評価損 4 億 93 百万円を計上した結果、税引前四半期純利益は 26 億 31 百万円（前年同期は△21 億 98 百万円）、四半期純利益は 23 億 88 百万円（前年同期は△38 億 15 百万円）となりました。

なお、当連結会計年度より、収益計上基準において半導体製造装置本体の全て及び設置を伴う計測機器本体について設置完了基準を適用することとした結果、従来の方法によった場合に比較して、当第 2 四半期連結累計期間の売上高が 2 億 73 百万円、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益がそれぞれ 1 億 9 百万円減少しています。

当第 2 四半期連結累計期間のセグメント別概況は以下の通りです。

#### [半導体製造装置部門]

半導体製造装置部門では、スマートフォン（高性能携帯電話）、タブレット P C などの需要増加を背景に半導体メーカー各社の設備投資が活発化したことから、検査工程向け、組立工程向けともに、東南アジア、台湾、韓国などでの受注・売上が堅調でした。

この結果、同部門の受注高は 198 億 2 百万円（前年同期比 188.1%増）、売上は 167 億 30 百万円（前年同期比 140.7%増）、営業利益は 16 億 99 百万円（前年同期は△21 億 12 百万円）となりました。

#### [計測機器部門]

計測機器部門では、主要ユーザーである自動車関連業界や工作機械業界において、中国等アジア新興国主体に市況が堅調に推移し設備投資も回復を続ける一方、航空機やエネルギー産業向け、官公庁や中小企業向けの増強などに注力しました。

この結果、同部門の受注高は 79 億 29 百万円（前年同期比 96.2%増）、売上は 68 億 32 百万円（前年同期比 51.0%増）、営業利益は 12 億 71 百万円（前年同期比 928.6%増）となりました。

### (2) 連結財政状態に関する定性的情報

#### ① 資産、負債及び純資産の状況

当第 2 四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ 40 億 57 百万円増加し、735 億 42 百万円となりました。増減の主な要因は、受取手形及び売掛金の増加 29 億 81 百万円、現金及び預金の増加 19 億 89 百万円、たな卸資産の増加 9 億 80 百万円等であります。

当第 2 四半期末における負債は、前連結会計年度末に比べ 15 億 79 百万円増加し、320 億 14 百万円となりました。増減の主な要因は、支払手形及び買掛金の増加 32 億 20 百万円、長期借入金の減少 19 億 44 百万円等であります。

当第 2 四半期末における純資産は、前連結会計年度末に比べ 24 億 77 百万円増加し、415 億 27 百万円となりました。増減の主な要因は、利益剰余金の増加 23 億 8 百万円等であります。

② キャッシュ・フローの状況

当第 2 四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ 18 億 75 百万円増加、連結範囲の変更に伴う増加 1 億 13 百万円を加え、140 億 16 百万円となりました。

当第 2 四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動による資金は、32 億 32 百万円の増加となりました。これは主に税金等調整前当期純利益の増加 26 億 31 百万円、売上債権の増加 35 億 17 百万円、たな卸資産の増加 8 億 2 百万円、仕入債務の増加 32 億 66 百万円等によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動による資金は、8 億 69 百万円の増加となりました。これは主に有形固定資産の売却による収入 9 億 81 百万円等によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動による資金は、20 億 98 百万円の減少となりました。これは主に長期借入金の返済による支出 19 億 44 百万円等によるものです。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

今後の内外経済情勢は、半導体業界における一部不透明感の広がりが懸念されるものの、アジアを中心に引き続き堅調に推移するものと思われま。このような状況の下、当連結会計期間において売上高及び利益が前回予想よりも増加する見込となったことから、平成 22 年 8 月 13 日に公表した通期の連結業績予想を以下の通り修正いたします。

通期の連結業績予想

(単位：百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1 株当たり 当期純利益
前回発表予想 (A)	45,000	4,000	3,100	3,300	80.05 円
今回修正予想 (B)	47,000	5,000	4,000	3,800	92.20 円
増減額 (B-A)	2,000	1,000	900	500	
増減率 (%)	4.4%	25.0%	29.0%	15.2%	

## 2. その他の情報

### (1) 重要な子会社の異動の概要

該当事項はありません。

### (2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

#### 1. 簡便な会計処理

##### ① 固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法によっております。

##### ② 繰延税金資産の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法により算定しております。

#### 2. 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

該当事項はありません。

### (3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

#### ① 会計基準等の改正に伴う変更

##### 資産除去債務に関する会計基準の適用

第1四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

#### ② ①以外の変更

該当事項はありません。

### 3. 四半期連結財務諸表

#### (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	当第2四半期連結会計期間末 (平成22年 9月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年 3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	14,044	12,055
受取手形及び売掛金	18,493	15,511
商品及び製品	1,029	984
仕掛品	10,154	9,362
原材料及び貯蔵品	2,460	2,317
その他	1,452	1,675
貸倒引当金	△ 232	△ 202
流動資産合計	47,402	41,703
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	7,634	7,917
その他（純額）	9,041	9,548
有形固定資産合計	16,676	17,466
無形固定資産		
のれん	1,663	1,830
その他	468	590
無形固定資産合計	2,131	2,420
投資その他の資産		
その他	7,363	8,547
貸倒引当金	△ 31	△ 652
投資その他の資産合計	7,331	7,894
固定資産合計	26,139	27,782
資産合計	73,542	69,485

(単位：百万円)

	当第2四半期連結会計期間末 (平成22年 9月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年 3月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	11,405	8,185
短期借入金	1,300	1,300
未払法人税等	246	75
引当金	444	339
その他	6,012	5,808
流動負債合計	19,408	15,709
固定負債		
社債	3,000	3,000
長期借入金	6,440	8,384
退職給付引当金	2,405	2,363
役員退職慰労引当金	82	114
その他	678	863
固定負債合計	12,606	14,725
負債合計	32,014	30,435
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	10,204	10,198
資本剰余金	21,222	21,216
利益剰余金	10,295	7,987
自己株式	△ 107	△ 107
株主資本合計	41,614	39,294
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△ 186	△ 194
為替換算調整勘定	△ 38	△ 195
評価・換算差額等合計	△ 224	△ 390
新株予約権	137	146
純資産合計	41,527	39,050
負債純資産合計	73,542	69,485

(2) 四半期連結損益計算書  
第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成21年 4月 1日 至 平成21年 9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日)
売上高	11,476	23,562
売上原価	10,762	16,469
売上総利益	714	7,093
販売費及び一般管理費		
販売費	1,796	2,712
一般管理費	906	1,410
販売費及び一般管理費合計	2,702	4,122
営業利益又は営業損失(△)	△ 1,988	2,971
営業外収益		
受取利息	7	1
受取配当金	103	28
雇用調整助成金収入	132	—
貸倒引当金戻入額	—	57
その他	182	66
営業外収益合計	425	154
営業外費用		
支払利息	223	283
資金調達費用	273	—
為替差損	315	559
その他	10	29
営業外費用合計	821	872
経常利益又は経常損失(△)	△ 2,384	2,253
特別利益		
土地売却益	—	872
新株予約権戻入益	186	—
特別利益合計	186	872
特別損失		
投資有価証券評価損	—	493
特別損失合計	—	493
税金等調整前四半期純利益 又は税金等調整前四半期純損失(△)	△ 2,198	2,631
法人税、住民税及び事業税	166	211
法人税等調整額	1,450	32
法人税等合計	1,617	243
少数株主損益調整前四半期純利益	—	2,388
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△ 3,815	2,388

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成21年 4月 1日 至 平成21年 9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益 又は税金等調整前四半期純損失 (△)	△ 2,198	2,631
減価償却費	1,046	874
のれん償却額	166	166
株式報酬費用	17	3
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,194	42
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	3	△ 31
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 101	△ 591
受取利息及び受取配当金	△ 110	△ 30
支払利息	223	283
新株予約権戻入益	△ 186	—
土地売却損益 (△は益)	—	△ 872
投資有価証券評価損益 (△は益)	—	493
売上債権の増減額 (△は増加)	1,950	△ 3,517
たな卸資産の増減額 (△は増加)	3,410	△ 802
仕入債務の増減額 (△は減少)	△ 2,280	3,266
その他	△ 984	1,284
小計	△ 238	3,202
利息及び配当金の受取額	36	30
利息の支払額	△ 241	△ 292
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△ 127	291
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 572	3,232
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の預入による支出	△ 11	△ 11
定期預金の払戻による収入	11	11
有形固定資産の取得による支出	△ 53	△ 69
有形固定資産の売却による収入	—	981
無形固定資産の取得による支出	△ 0	△ 6
投資有価証券の取得による支出	△ 1	△ 1
子会社株式の取得による支出	—	△ 14
貸付けによる支出	△ 14	△ 21
貸付金の回収による収入	1	1
その他	1	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 67	869
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△ 4,000	—
長期借入れによる収入	1,000	—
長期借入金の返済による支出	△ 3,015	△ 1,944
リース債務の返済による支出	△ 185	△ 154
その他	△ 0	△ 0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,200	△ 2,098
現金及び現金同等物に係る換算差額	12	△ 127
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△ 6,827	1,875
現金及び現金同等物の期首残高	17,586	12,027
連結の範囲の変更に伴う 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	—	113
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,758	14,016

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項ありません。

(5) セグメント情報

[事業の種類別セグメント情報]

前第2四半期連結累計期間(自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)

	半導体製造 装置関連事業 (百万円)	計測機器 関連事業 (百万円)	計 (百万円)	消去又は全社 (百万円)	連結 (百万円)
売上高及び営業損益					
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	6,950	4,526	11,476	—	11,476
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	(—)	—
計	6,950	4,526	11,476	(—)	11,476
営業利益(又は営業損失(△))	△ 2,112	123	△ 1,988	—	△ 1,988

(注) 1 当社の事業区分は製品の種類・性質及び販売市場等の類似性を考慮して行っております。

2 各事業区分の主要製品

- (1) 半導体製造装置関連事業 … ウェーハブロービングマシン、ウェーハダイシングマシン、ポリッシュ・グラインダー、ウェーハマニファクチャリングマシン、CMP装置、
- (2) 計測機器関連事業 …… 三次元座標測定機、真円度・円柱形状測定機、表面粗さ・輪郭形状測定機、マシンコントロールゲージ、電気マイクロメータ、各種自動測定・選別・組立機

[所在地別セグメント情報]

前第2四半期連結累計期間(自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)

	日本 (百万円)	米国 (百万円)	ドイツ (百万円)	韓国 (百万円)	計 (百万円)	消去 又は全社 (百万円)	連結 (百万円)
売上高及び営業損益							
売上高							
(1) 外部顧客に対する売上高	10,386	619	296	174	11,476	—	11,476
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	522	—	—	105	627	(627)	—
計	10,908	619	296	280	12,104	(627)	11,476
営業損失	△ 1,882	△ 65	△ 31	△ 8	△ 1,988	—	△ 1,988

(注) 国別の区分の方法

国別の区分の方法は事業活動の地域的独立性に基づいて決定しております。

[海外売上高]

前第2四半期連結累計期間(自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)

	東アジア	東南アジア	北米	ヨーロッパ	その他地域	計
I 海外売上高(百万円)	4,612	695	617	322	106	6,354
II 連結売上高(百万円)	—	—	—	—	—	11,476
III 連結売上高に占める 海外売上高の割合(%)	40.2	6.1	5.4	2.8	0.9	55.4

(注) 1 海外売上高は当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

2 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1) 国又は地域の区分の方法は地理的近接度によっております。

(2) 各区分に属する主な国又は地域

- 東アジア…………… 韓国、台湾、中国
- 東南アジア…………… タイ、シンガポール、マレーシア、
- 北米 ……………… 米国、カナダ
- ヨーロッパ ……………… ドイツ、英国、イタリア
- その他の地域 …… インド、ブラジル

[セグメント情報]

① 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社では、半導体社及び計測社の社内カンパニーそれぞれが取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

従って、当社は社内カンパニーを基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「半導体製造装置」及び「計測機器」の2つを報告セグメントとしております。

「半導体製造装置」は、半導体製造工程で使用される加工・検査装置を製造販売し、「計測機器」は三次元座標測定機、表面粗さ・輪郭形状測定機等の精密測定機器類を製造販売しております。

② 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第2四半期連結累計期間(自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)

(単位：百万円)

	報告セグメント			合計
	半導体製造装置	計測機器	計	
売上高				
外部顧客への売上高	16,730	6,832	23,562	23,562
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—
計	16,730	6,832	23,562	23,562
セグメント利益	1,699	1,271	2,971	2,971

③ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

④ 報告セグメントの変更等に関する事項

該当事項ありません。

⑤ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項ありません。

(追加情報)

第1四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年3月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日)を適用しております。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項ありません。

4. 補足情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

(単位:百万円)

セグメントの名称	前第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)	
	半導体製造装置	5,292		16,764
計測機器	4,023		7,124	
合計	9,316		23,889	

(注) 1 上記生産実績は販売価額によっております。  
2 上記金額には消費税等は含まれておりません。

(2) 受注実績

(単位:百万円)

セグメントの名称	前第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
半導体製造装置	6,872	4,539	19,802	8,740
計測機器	4,041	1,308	7,929	2,960
合計	10,914	5,847	27,731	11,701

(注) 上記金額には消費税等は含まれておりません。

(3) 販売実績

(単位:百万円)

セグメントの名称	前第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)	
	半導体製造装置	6,950		16,730
計測機器	4,526		6,832	
合計	11,476		23,562	

(注) 上記金額には消費税等は含まれておりません。